



Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所
(証券コード:6125)

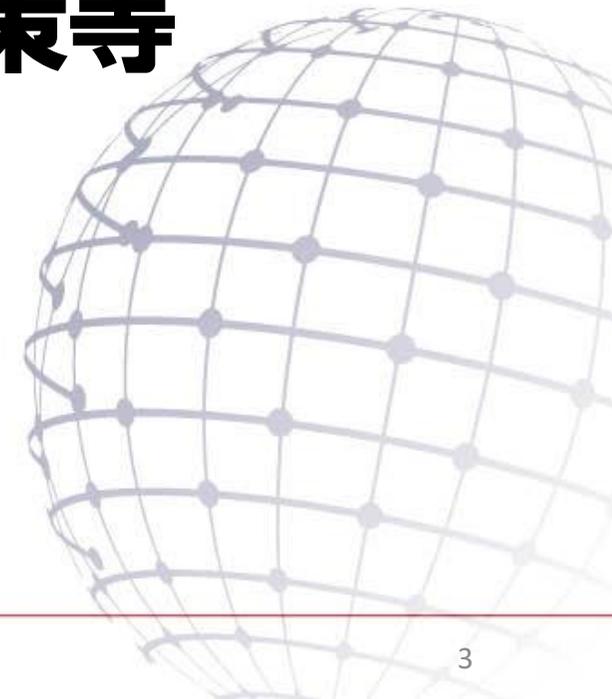
2021年3月期決算説明資料

2021年6月16日

1. 新型コロナウイルス感染症の影響、当社施策等
2. 2021年3月期 決算概況
3. 2022年3月期 決算予想
4. 新型コロナウイルス感染症と中期経営計画
5. 半導体関連装置 事業概要と今後の取り組み

Appendix

1. 新型コロナウイルス感染症の影響 感染症への当社施策等



新型コロナウイルス感染症にかかる当社内部施策（防疫対策）

引き続き従業員の健康を第一に考え、その上での安定的な操業を目指して防疫対策を徹底中

項目	該当拠点
入社時の検温、発熱時・体調不良時の自宅待機	全拠点
在宅勤務、時差出勤等	全拠点
テレビ会議システムの活用	全拠点
帰国従業員の自宅待機、接待自粛、会議の縮小、 部外者の会社施設への立ち入り制限	国内全拠点
食堂、工場などレイアウト変更、主要箇所定期消毒	全拠点
従業員に対するマスク配布と着用の徹底、外出自粛要請等	全拠点
来場者入場時の検温と入退出管理の実施	全拠点

国内拠点、海外拠点



Okamoto Machine Tool Europe GmbH



Birmingham Sales Office

Herford Sales Office (D)

Shenzhen Sales Office



Okamoto (Thai) Co., Ltd.



Okamoto (Singapore) Pte, Ltd.



Okamoto Machinery (Changzhou) Co., Ltd.



Dalian Sales Office

Shanghai Sales Office



Okamoto Corporation

Louisville, KY Sales Office

Windsor, CT Sales Office

Santa Fe Spring, CA Sales Office



● ... 生産拠点

● ... 販売拠点

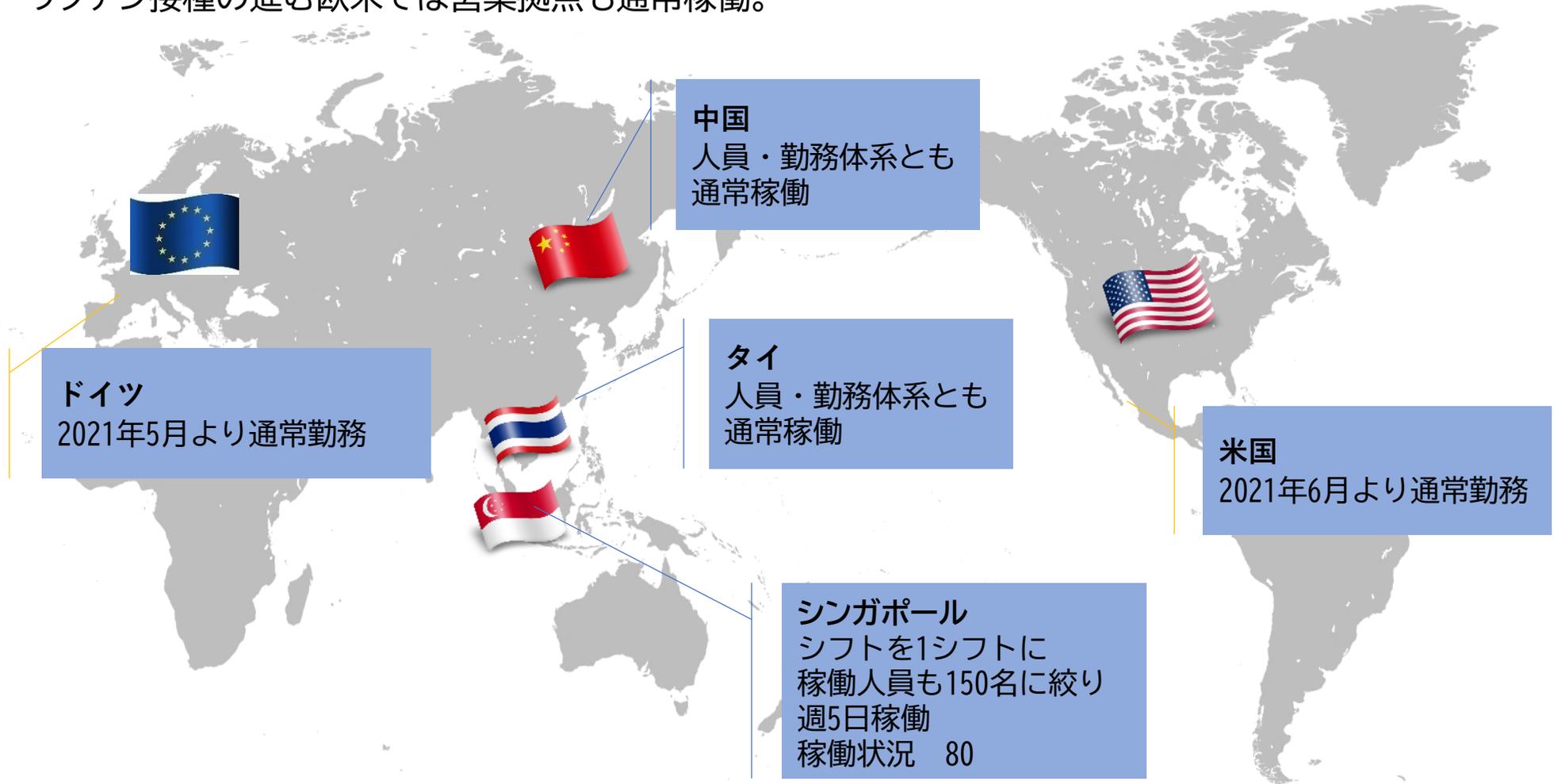
富山営業所
 名古屋営業所
 広島営業所
 福岡営業所
 仙台営業所
 本社/安中工場
 北関東営業所
 首都圏営業所
 技研(株)
 岡本工機(株)
 静岡営業所



生産・販売拠点	
国内	9拠点
北米	4拠点
欧州	3拠点
中国	4拠点
アジア	2拠点

新型コロナウイルス感染症にかかる海外各拠点の状況

生産拠点については中国、タイは通常稼働。シンガポールも80%の稼働にワクチン接種が進む欧米では営業拠点も通常稼働。



withコロナの営業活動展開

コロナ禍の中、オンラインの活用やWebサイトを通じた製品紹介など
withコロナの時代の営業スタイルが進展。afterコロナの時代にも通じる効率的な営業を模索



お客様とつながる、
**OKAMOTO
WEB SHOWROOM**

WEBセミナーの限定配信の他、
様々な情報を掲載しております！

こちらを **CLICK!** 

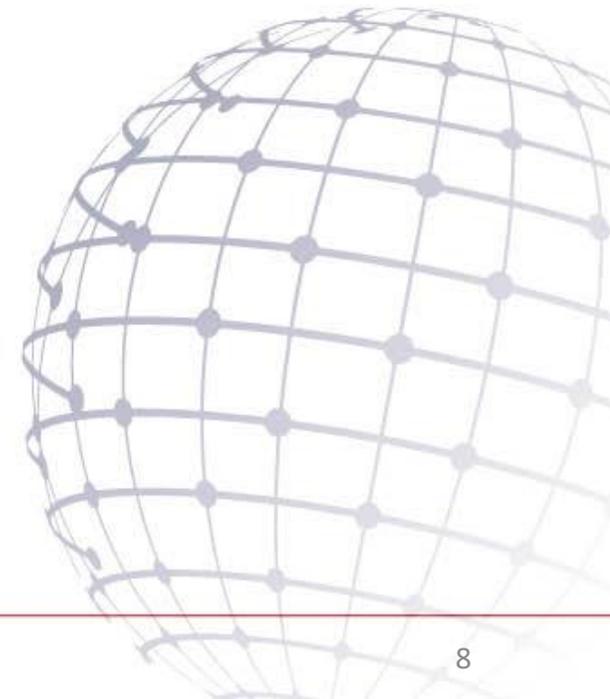
弊社工場へ
来社不要！

**オンラインを活用した
打合せ・テスト研削実施中**

詳しくは、OKAMOTO担当営業まで
お気軽にお尋ねください！



2. 2021年3月期 決算概況



2021年3月期の市場環境

■ 国内市場

- 工作機械は新型コロナウイルス感染症の影響から設備投資計画の延期が多く、受注は前年同期比減少。売上においても営業活動の制限が影響し汎用研削盤の販売が伸び悩む
- 半導体については、新型コロナウイルス感染症の感染対策からテレワーク移行が進み、5Gやデータセンター向けの半導体デバイス需要が増加、つれて半導体業界の設備投資が活発化。ウェーハ生産用ファイナルポリッシャーの受注好調。売上も大型案件が寄与

■ 海外市場

- 北米市場は、ワクチン接種の進展から経済活動が再開。設備投資意欲が戻り、半導体、医療機器関連も回復基調
- 欧州は第3四半期までコロナ禍による行動規制や自動車産業の低迷により業績悪化第4四半期に入り、イタリア、中欧より受注増加し、直近ではドイツも回復基調に
- アジア市場では中国ではコロナの封じ込めや景気刺激策の効果で消費も回復、テレワーク・半導体・自動車・工作機械関連を中心に製造業も好況。半導体については国産化が加速し、設備投資意欲が強くファイナルポリッシャーの受注好調

米国、中国での取り組み

米国

- ◆ 好調な半導体、医療、セラミックス関連へ門型・円筒・複合研削盤の拡販を推進
- ◆ リモートセールスが継続されるため、各種販売ツールの充実を図り、タイムリーな紹介を強化
- ◆ 汎用研削盤の第一優先機種を戦略機SA1とし拡販に注力し市場シェアを上げる



中国

- ◆ テレワーク関連の需要は依然堅調であり、小型機を中心に汎用機からNC化への誘導を行う
- ◆ EV（電動車）化が加速しており、関連ワーク加工に焦点を絞り拡販
- ◆ リモートセールスを強化し、地域代理店との連携を行い高付加価値製品の販売を強化
- ◆ 小型成形研削盤の現地生産を加速させ、利益率アップを図る



業績ハイライト

(単位：百万円、%)

	2020年3月	2021年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	34,305	30,372	▲11.5%
売上総利益	10,330	8,494	▲17.8%
販売費及び一般管理費	7,740	6,588	▲14.9%
営業利益	2,589	1,905	▲26.4%
経常利益	2,420	1,869	▲22.7%
当期純利益	1,582	1,458	▲7.9%

※小数点第2位を四捨五入

(単位：百万円)

	2020年3月	2021年3月
	金額	金額
設備投資額	1,615	946
減価償却費	1,320	1,367
研究開発費	153	115

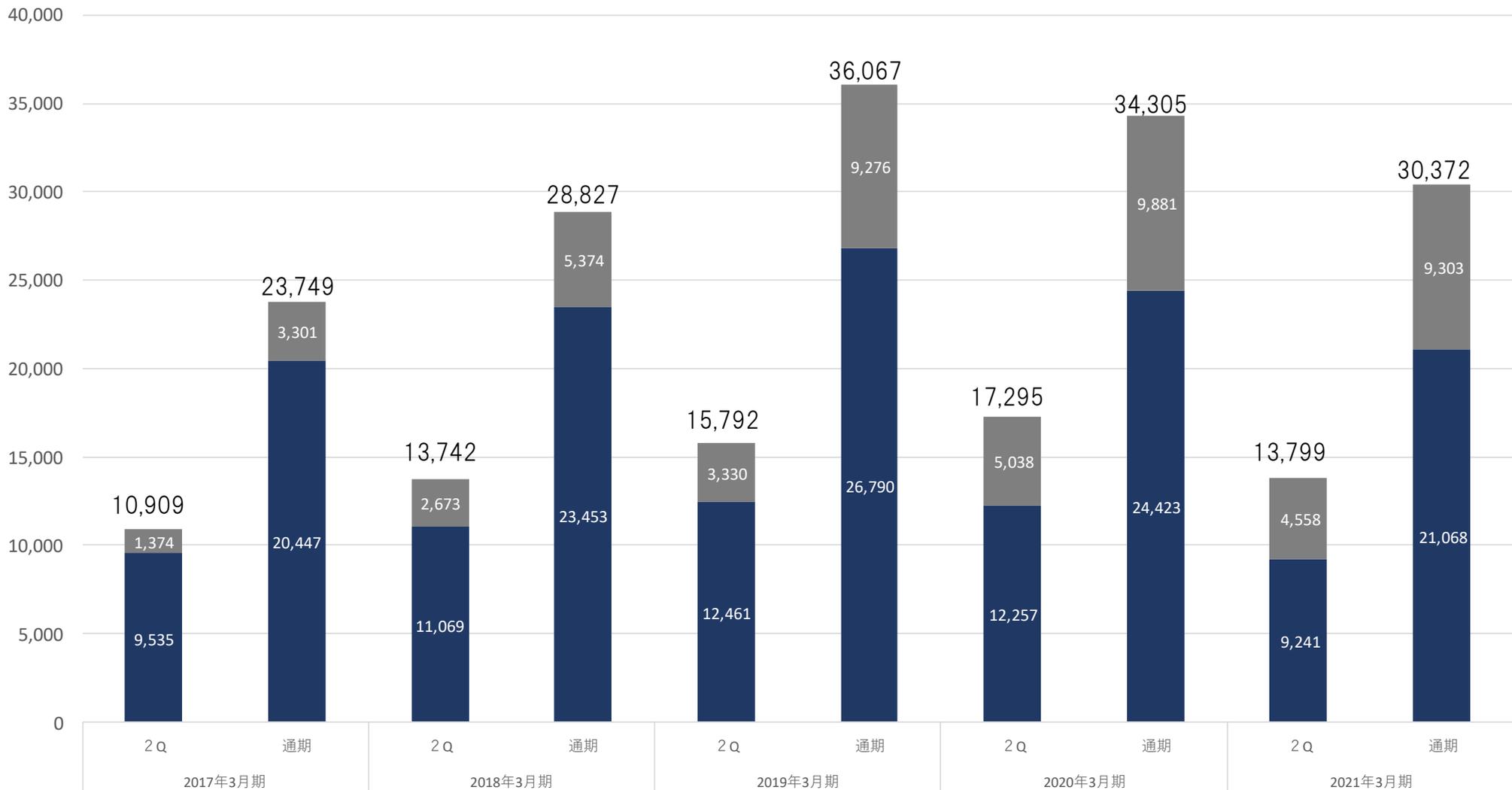
為替レート	2020年3月	2021年3月
米ドル	108.95	105.94
シンガポールドル	79.27	77.76
ユーロ	120.85	124.07
タイバーツ	3.51	3.42
人民元	15.59	15.65

※期中の平均レートで記載しております。

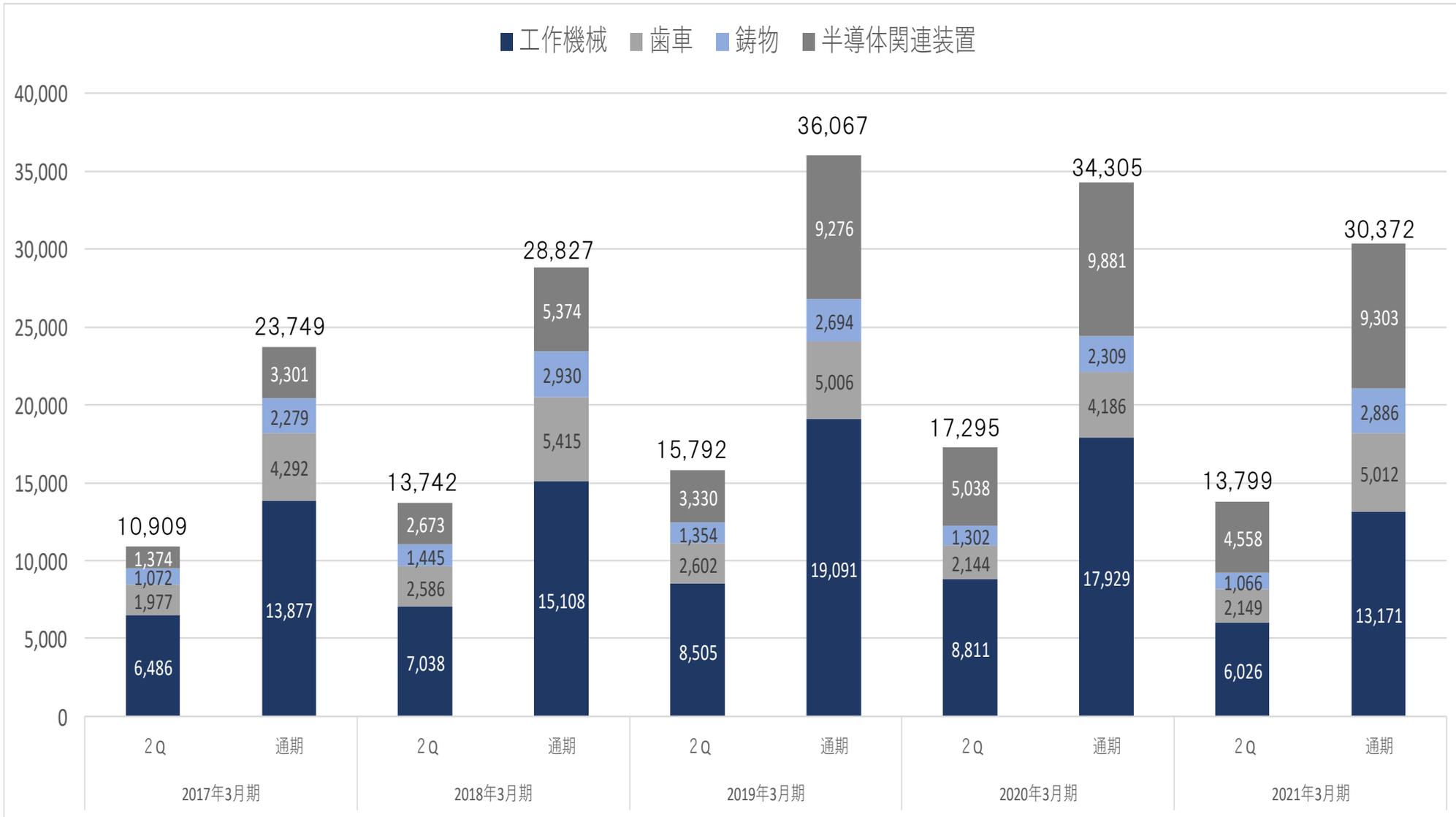
- 前期比で売上高は11.5% 経常利益は22.7%、当期利益は7.9%減少
- 工作機械は新型コロナウイルス感染症の影響が大きく売上、受注とも前年を大きく下回る
- 半導体は売上は国内向け大型案件が寄与、受注は半導体業界の設備投資意欲の継続から国内、中国向けが引き続き好調に推移

セグメント別売上高推移

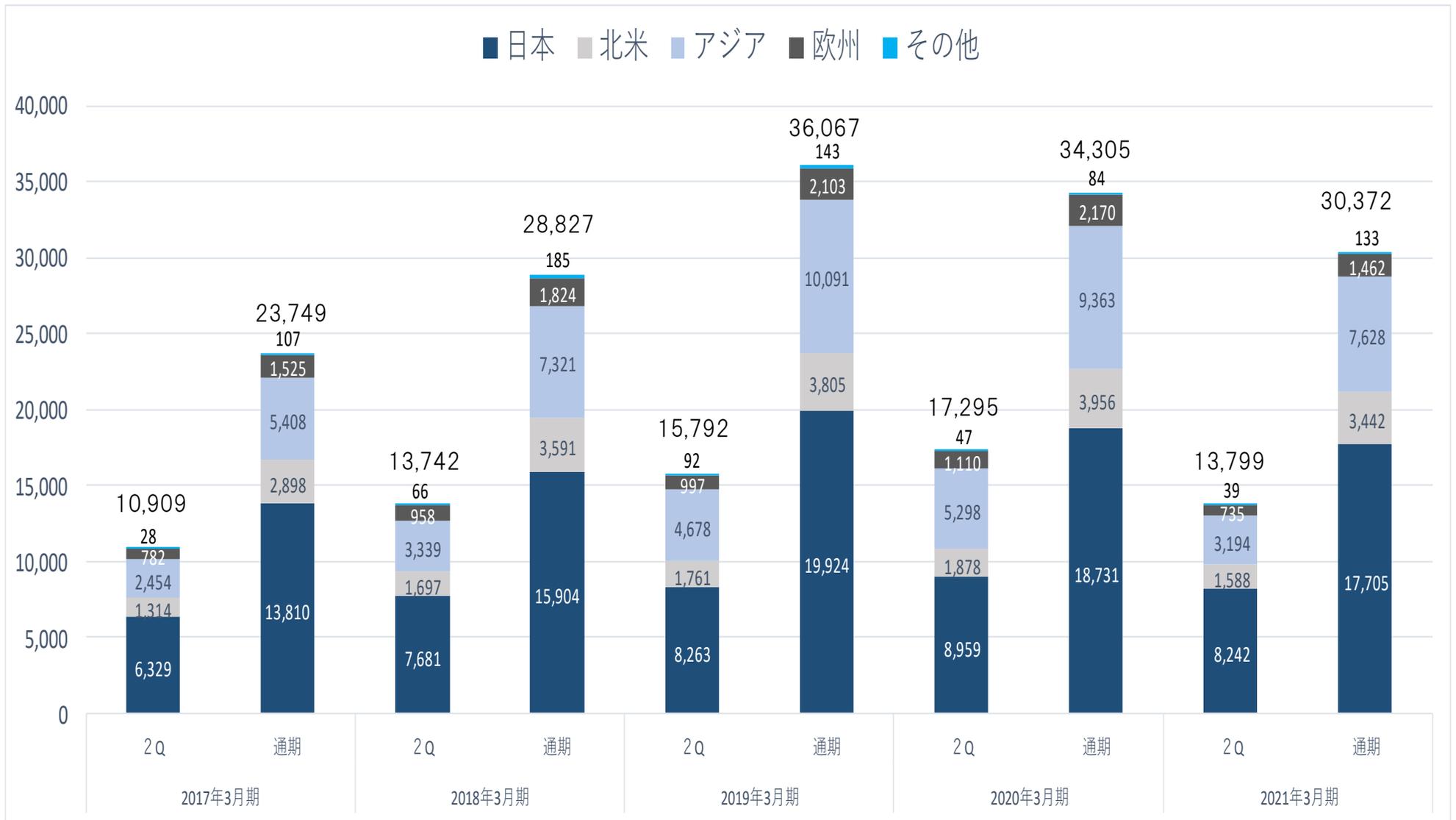
■ 工作機械 ■ 半導体関連装置



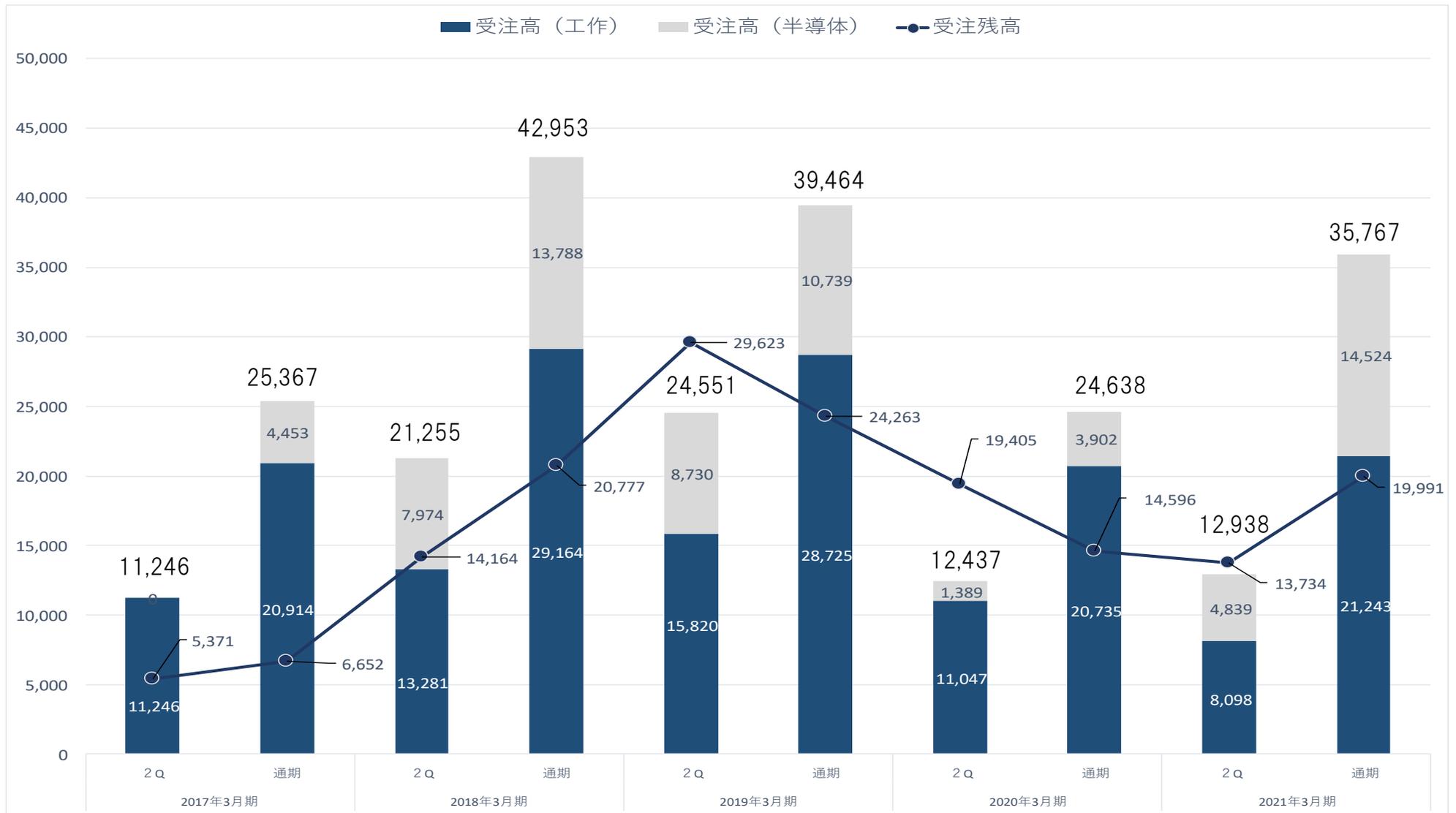
セグメント別売上高推移②



エリア別売上高推移



受注・受注残高



比較貸借対照表

(単位：百万円)

	2020年3月		2021年3月	
	金額	金額	金額	対前期末比
流動資産	22,793	23,444		+651
現金及び預金	3,400	4,925		+1,525
受取手形及び売掛金	8,576	9,391		+815
棚卸資産	10,487	8,987		▲1,500
有形・無形固定資産	10,085	9,952		▲133
投資等	1,286	1,653		+367
資産合計	34,164	35,050		+886

(単位：百万円)

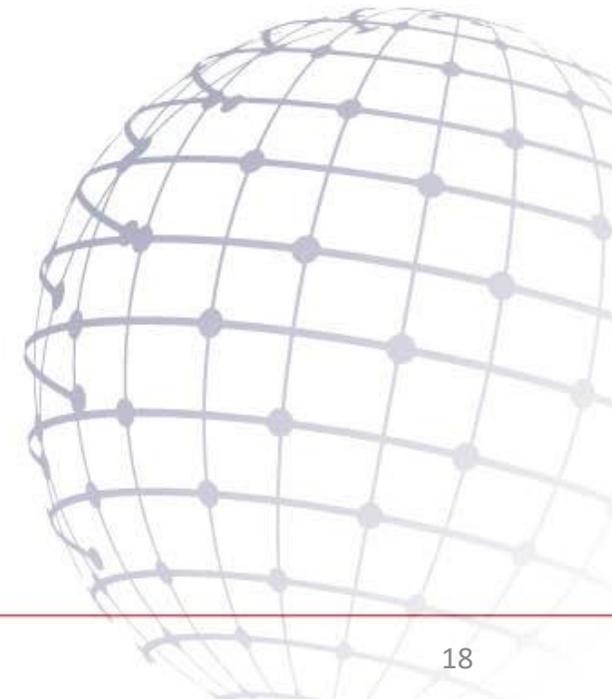
	2020年3月		2021年3月	
	金額	金額	金額	対前期末比
負債合計	21,053	19,969		▲1,084
流動負債	16,300	16,832		+532
固定負債	4,753	3,137		▲1,616
純資産合計	13,110	15,080		+1,970
負債資本合計	34,164	35,050		+886

比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2020年3月	2021年3月	
	金額	金額	対前期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	23	5,922	+5,899
税引前当期純利益	2,416	1,864	▲552
減価償却費	1,320	1,367	+47
売上債権の増減（▲は増加）	1,685	▲704	▲2,389
棚卸資産の増減（▲は増加）	▲682	1,729	+2,411
仕入債務の増減（▲は減少）	▲2,501	401	+2,902
その他	▲2,215	1,265	+3,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,159	▲919	+240
財務活動によるキャッシュ・フロー	245	▲3,690	▲3,935
換算差額	▲89	153	+242
現金・現金同等物残高	3,311	4,778	+1,467

3. 2022年3月期 決算予想



2022年3月期の工作機械関連の市場環境見通し

■ 国内市場

- 新型コロナウイルス感染症の影響を見極めながらも、引き続き半導体関連等の好調業種向け設備投資の増加を予想
- コロナ禍に対応した政府施策を注視し、施策に合わせた需要の掘り起こしに努める

■ 海外市場

- 中国市場においてはテレワーク関連需要向けで引続き好調を予想。欧州も前年度終盤からイタリア、中欧より受注が増加傾向。ドイツも回復基調が見られる
- 北米は政権交代後の経済政策による設備投資が活発化
前年度終盤からの需要増加を拡販に繋げる

2022年3月期の半導体関連装置の市場環境見通し

■ 国内市場

- 新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークなど新しいライフスタイルの常態化を予想、つれて5G関連も含め、半導体需要の増加が加速化すると予想

■ 海外市場

- 東アジアについて投資の加速化を予想
- 特に中国においては、米国からの輸出制限の影響により半導体関連事業の育成強化を予想

通期業績予想

引き続き半導体関連装置が業績を牽引 売上高340億円、経常利益27億円の達成を見込む

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期（予想）	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	30,372	34,000	-
売上総利益	8,494	10,340	-
販管費	6,588	7,590	-
営業利益	1,905	2,750	-
経常利益	1,869	2,700	-
当期純利益	1,458	2,000	-

※2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、対前期比増減率は記載していません。

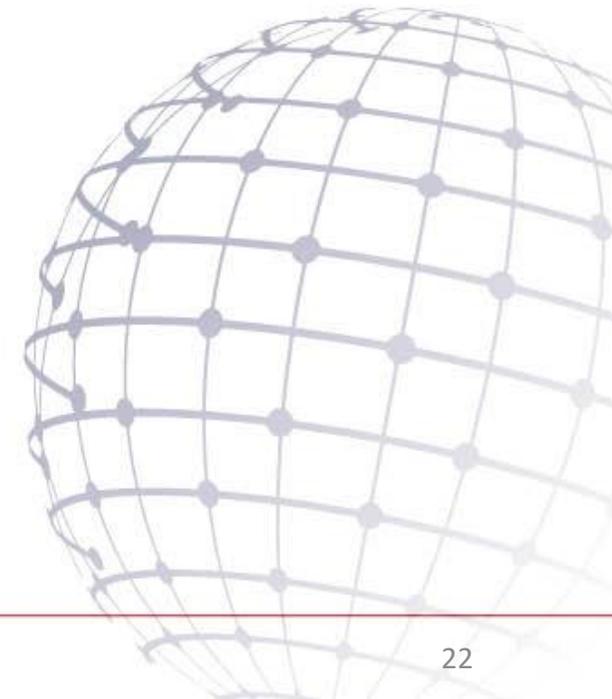
(単位：百万円)

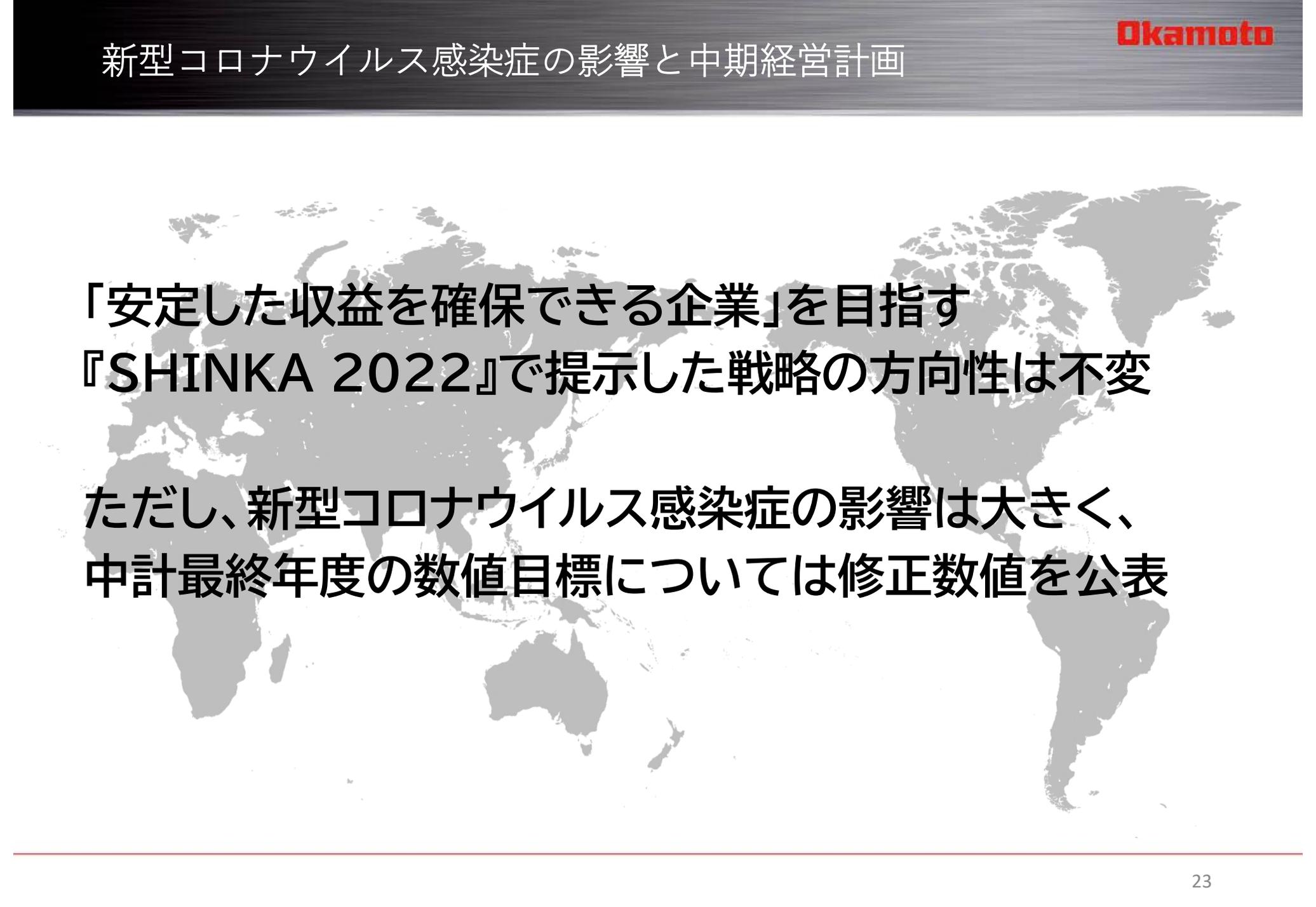
	2021年3月期	2022年3月期 (予定)
	金額	金額
設備投資額	946	2,132
減価償却費	1,367	1,382
研究開発費	115	146

為替レート	2021年3月期	2022年3月期 (予想)
米ドル	105.94	104.00
シンガポールドル	77.76	78.00
ユーロ	124.07	125.00
タイバーツ	3.42	3.40
人民元	15.65	15.80

※期中の平均レートで記載しております。

4. 新型コロナウイルス感染症と 中期経営計画

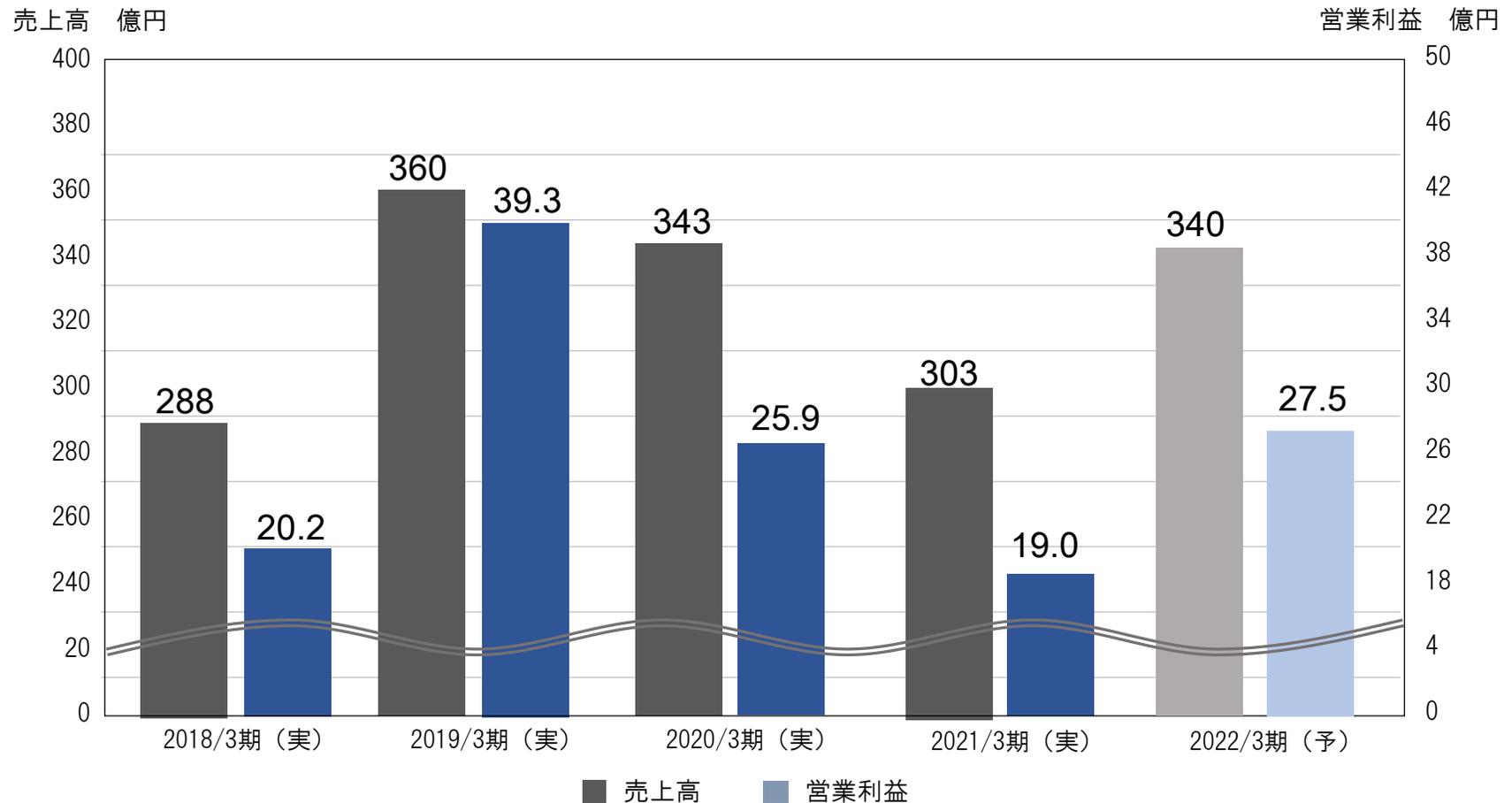


A faint, grayscale world map is visible in the background of the slide, centered behind the text.

「安定した収益を確保できる企業」を目指す
『SHINKA 2022』で提示した戦略の方向性は不変
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、
中計最終年度の数値目標については修正数値を公表

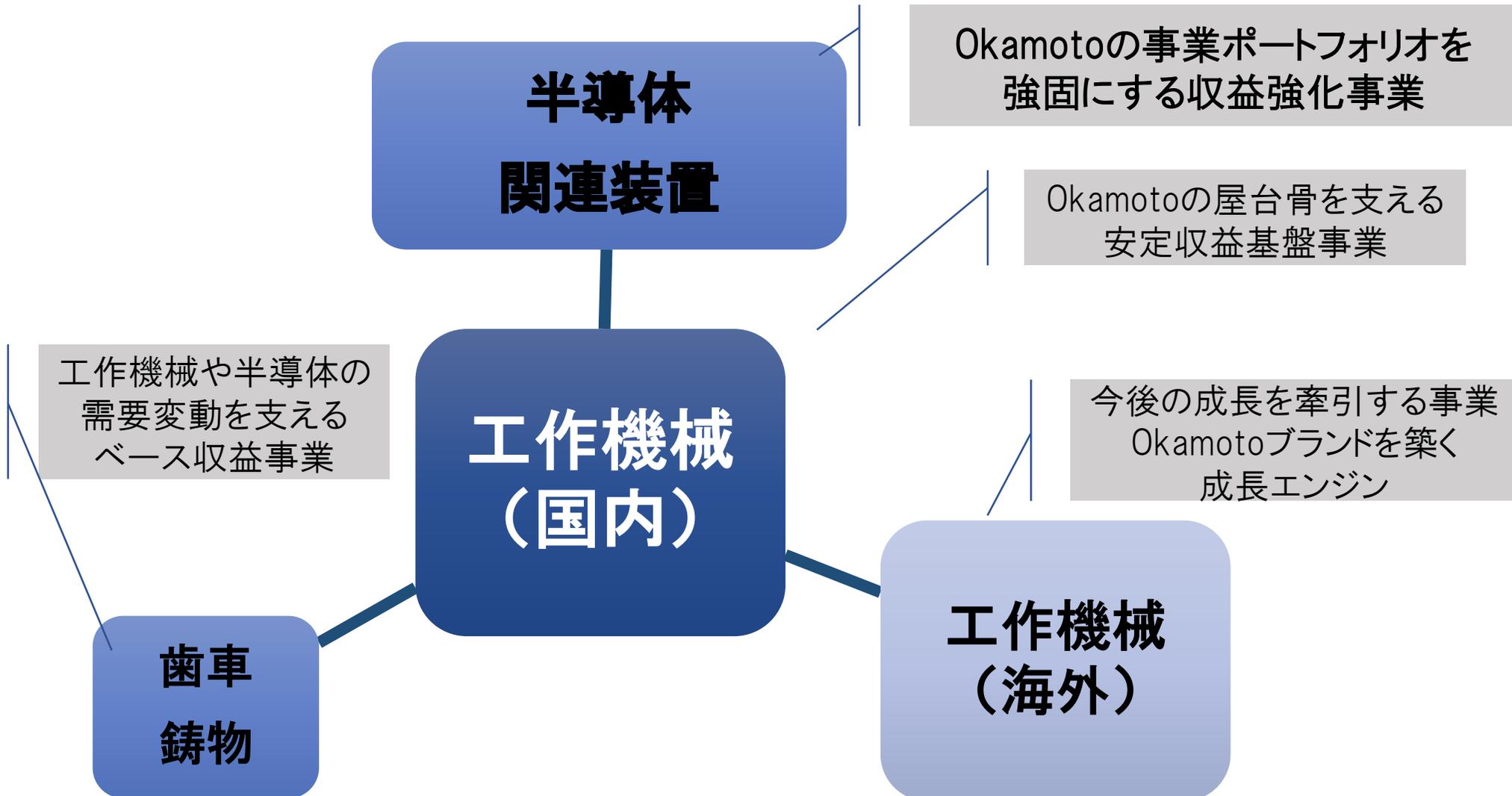
中期目標

新型コロナウイルス感染症の影響から中計最終年度の目標数字を修正
 売上高380億円を340億円、営業利益46億円を27.5億円、営業利益率12%を8%に



営業利益率目標 12% → 8%

各事業セグメントの位置づけ



安定した収益を 確保できる企業

ダウンサイドに強い安定した
収益基盤の強化

持続的成長のための
エンジン事業の育成

Okamotoブランドの再構築

顧客ライフタイムバリュー強化

B to B → B with B

サービス体制拡充、高付加価値機拡販

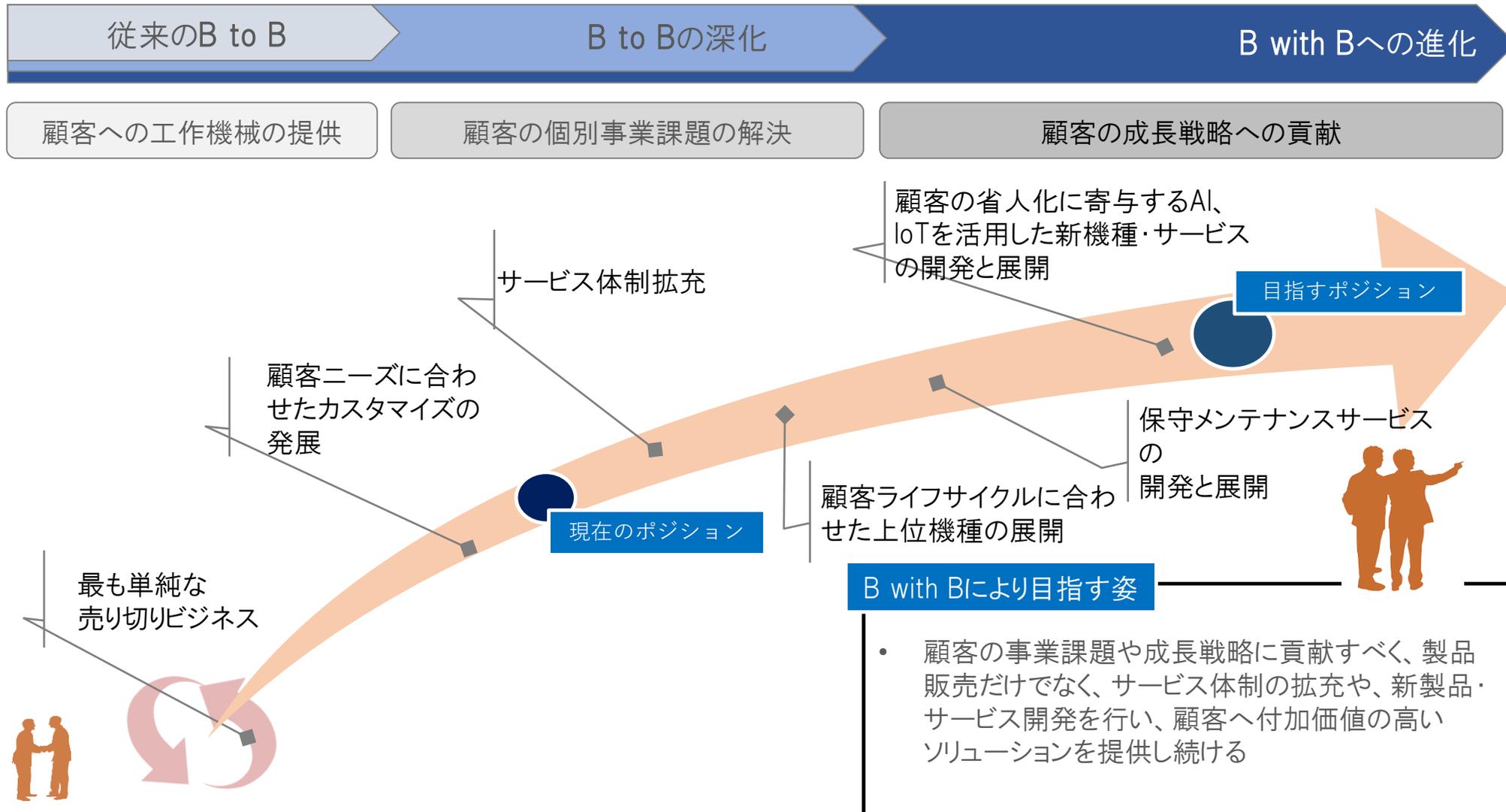
グローバル戦線拡充

マーケティング体制強化、管理体制強化

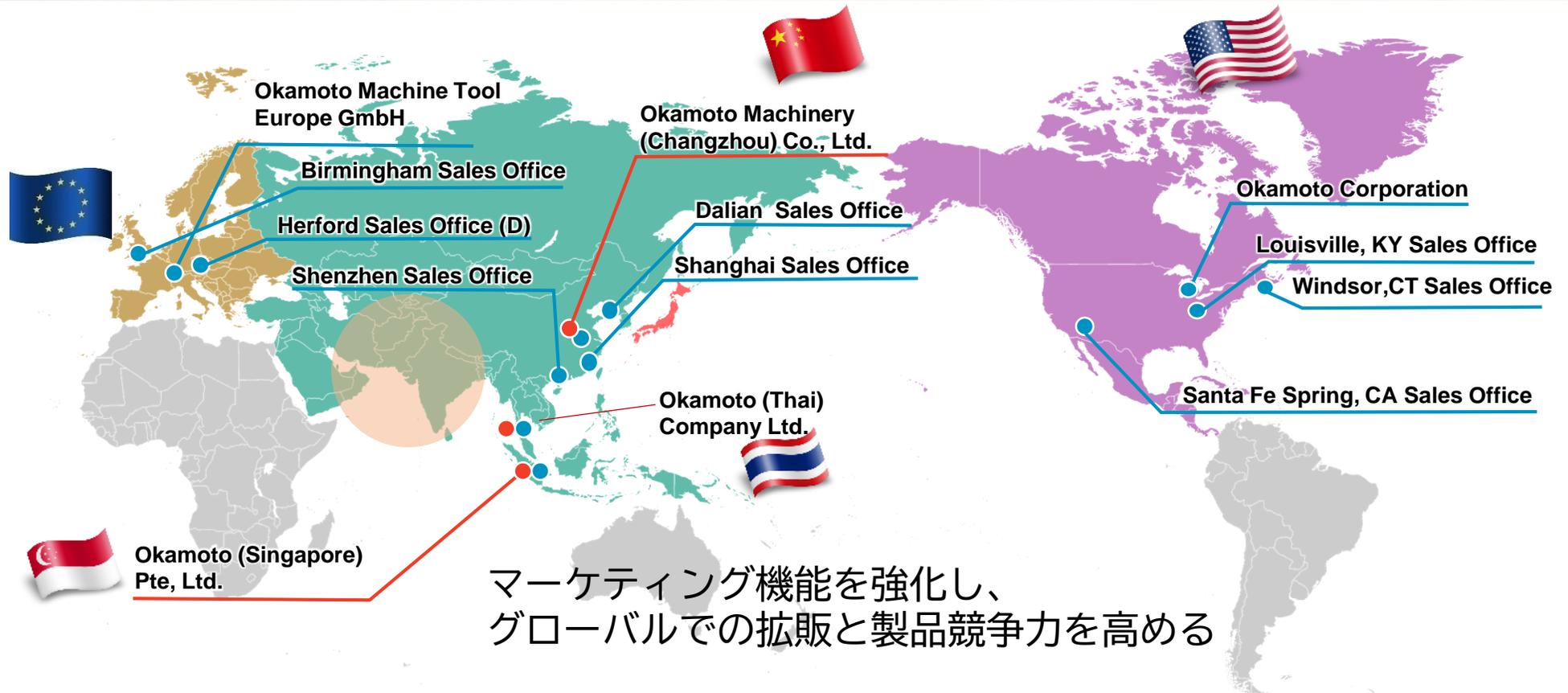
モノづくり改革

モノづくりの整流化、海外直送体制の確立

顧客ライフタイムバリューの強化



グローバル戦線の拡充



マーケティング機能を強化し、
グローバルでの拡販と製品競争力を高める

- ・ マーケティングにおけるPDCAの徹底
- ・ アプリケーションエンジニアの拡充
- ・ 機種別担当制の導入
- ・ 新拠点拡充（インド）

グローバル戦線の拡充 インド拠点創設

今後、投資活発化が見込まれるインドへ拠点を創設

- 代理店経由で500台弱の販売実績があるインド市場拡販の為、2021年上期を目途に現地法人を設立、きめ細かい販売及びサービス活動を行う
- 弊社の主な販売エリアは、PUNEを中心とした西エリアとBANGALOREを中心とした南エリアであることからマハラシュトラ州プネに現地法人設立でスタート

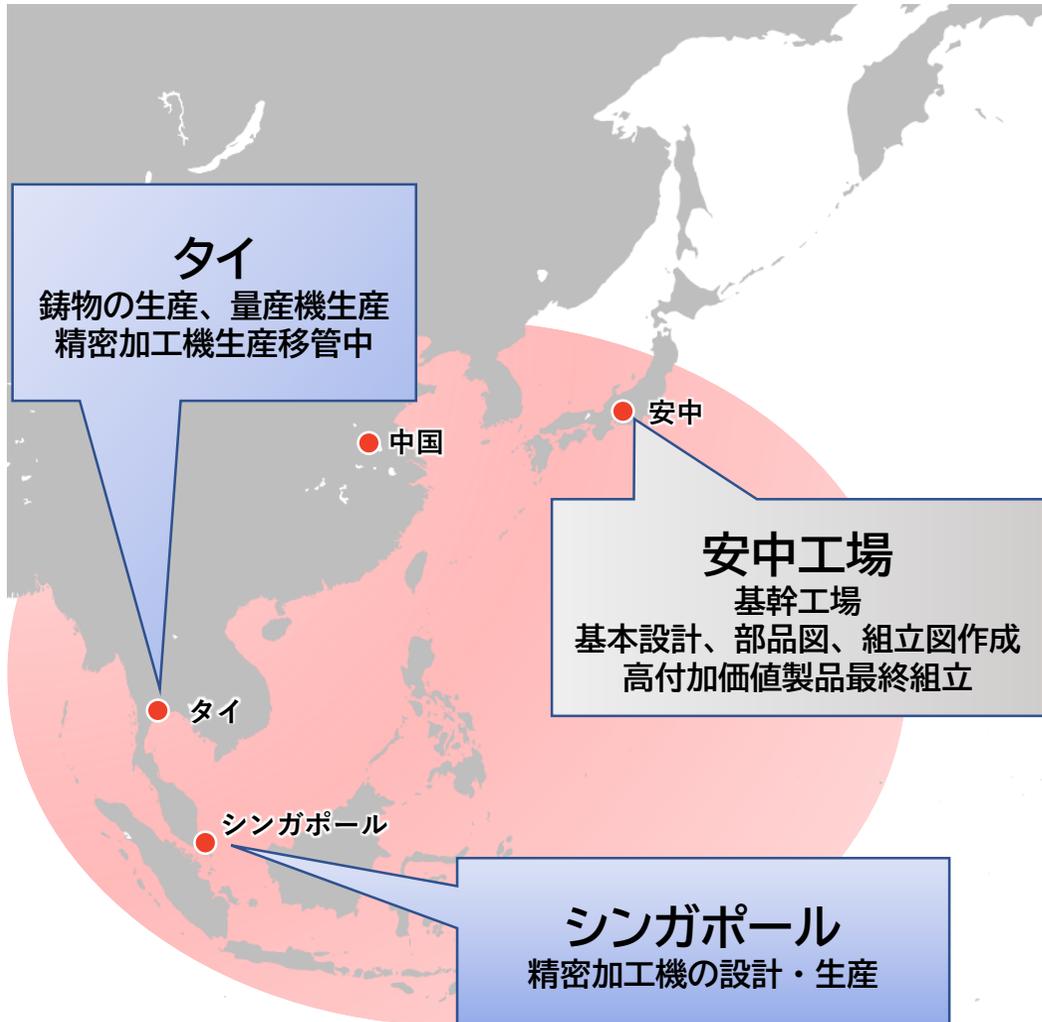


北部 Haryana,UP,Delhi,Noida
今後拡販のエリア

西部 Gujarat,Maharashtra,Karnataka
PUNEを中心とし当社研削盤の需要が高いエリア

南部 Tamil Nadu,Chennai,Coimbatore
BANGALOREを中心とし納入実績を重ねているエリア

モノづくり改革



モノづくりの整流化

- 生産・開発キャパシティの見える化をし、生産、開発、販売計画の連動と計画的なコストダウンを実施
- グローバル生産体制の適正化

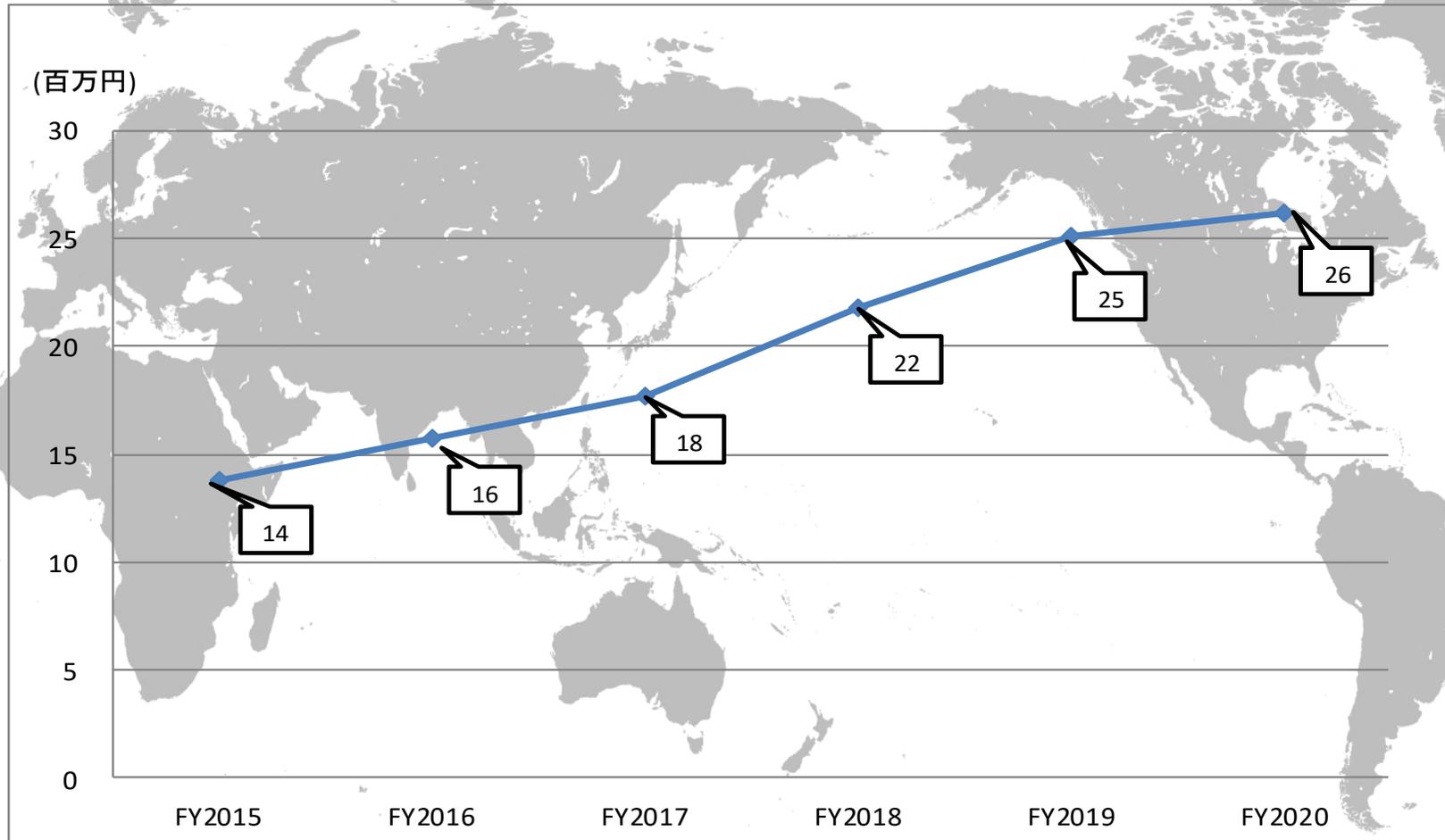
海外直送体制の確立

- 海外生産品の国内の販売先へ直接輸送可能な体制を構築することで納期短縮・費用削減を図る



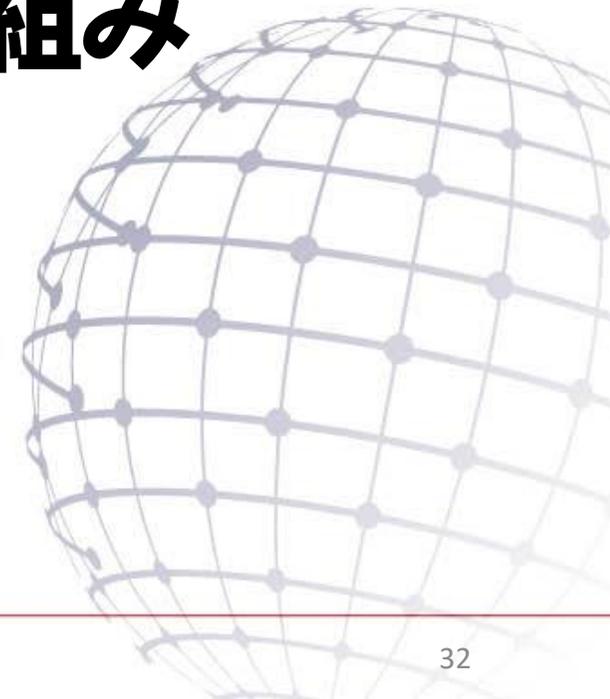
1台あたり機械単価推移

高付加価値製品の拡販を全社的なテーマに
半導体関連装置の構成比が高い時期ではあるものの、少しずつ成果が結実



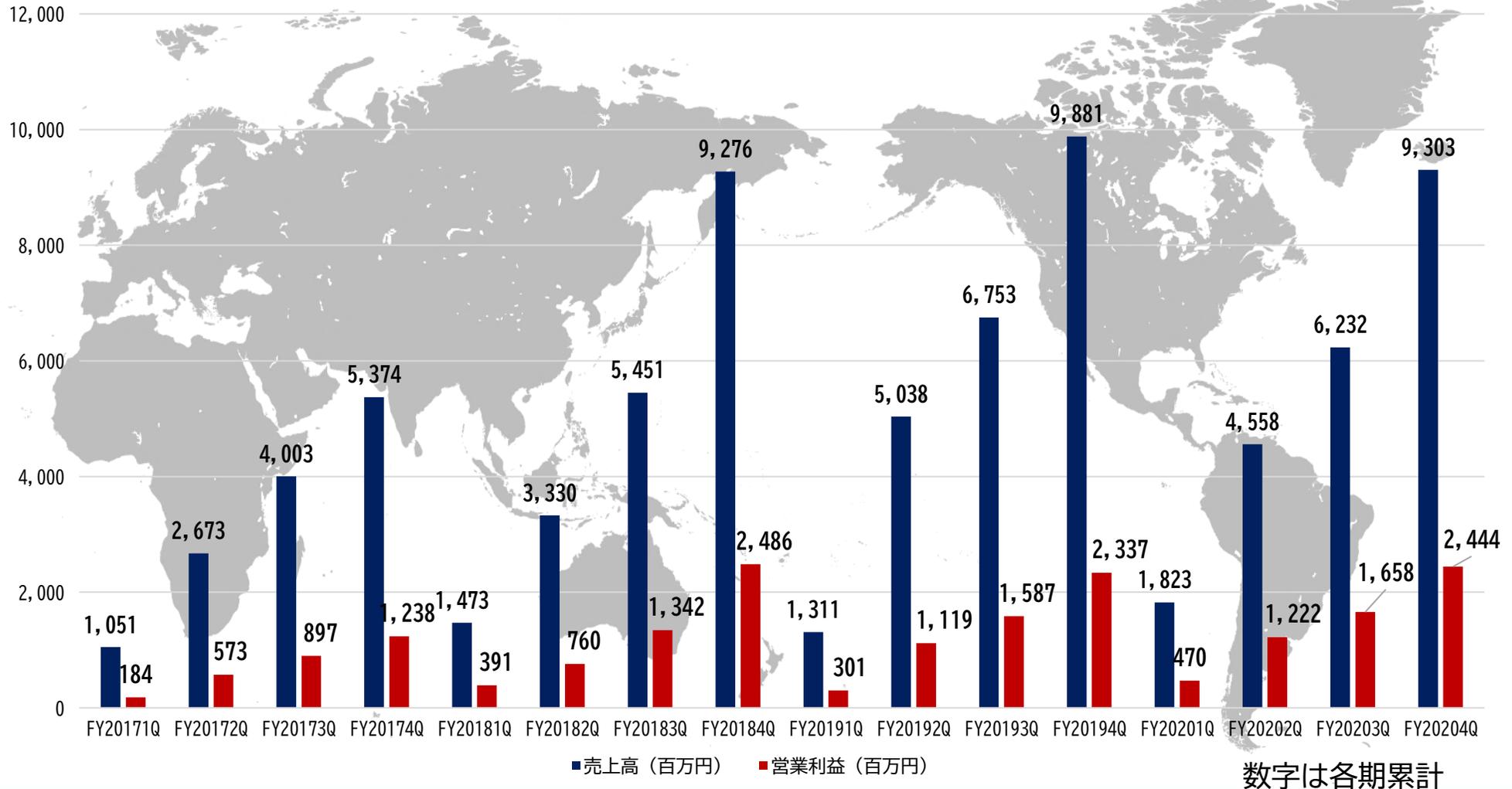
各年度の売上を総販売台数で除した1台あたり単価

5. 半導体関連装置 事業内容と今後の取り組み



半導体関連装置 売上高・セグメント（営業）利益推移 FY2017～

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今中期経営計画の期間
半導体関連装置は好調さを維持、業績を下支え中計目標「安定した収益を確保できる企業」に貢献



シリコンウェーハの製造工程

スライシング、ラッピング、エッチング、ポリッシングと流れるウェーハ加工工程の中で
 ポリッシング工程で主力機種PNXシリーズなどでファイナルポリッシャーで高いシェアを誇る

半導体シリコン材料工程

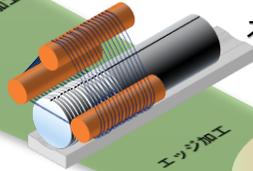


単結晶引き上げ (CZ法)



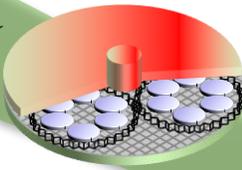
単結晶シリコンインゴット

外周・ノッチ加工



スライス加工

エッジ加工



ラップ加工

12" 対応高精度ウェーハ研削盤

研削加工



12" ウェーハ用



SVG 201D300



GNX 312

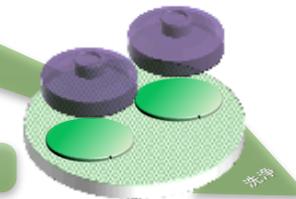


GNX 201D300

エッチング



ファイナルポリッシュ (CMP)



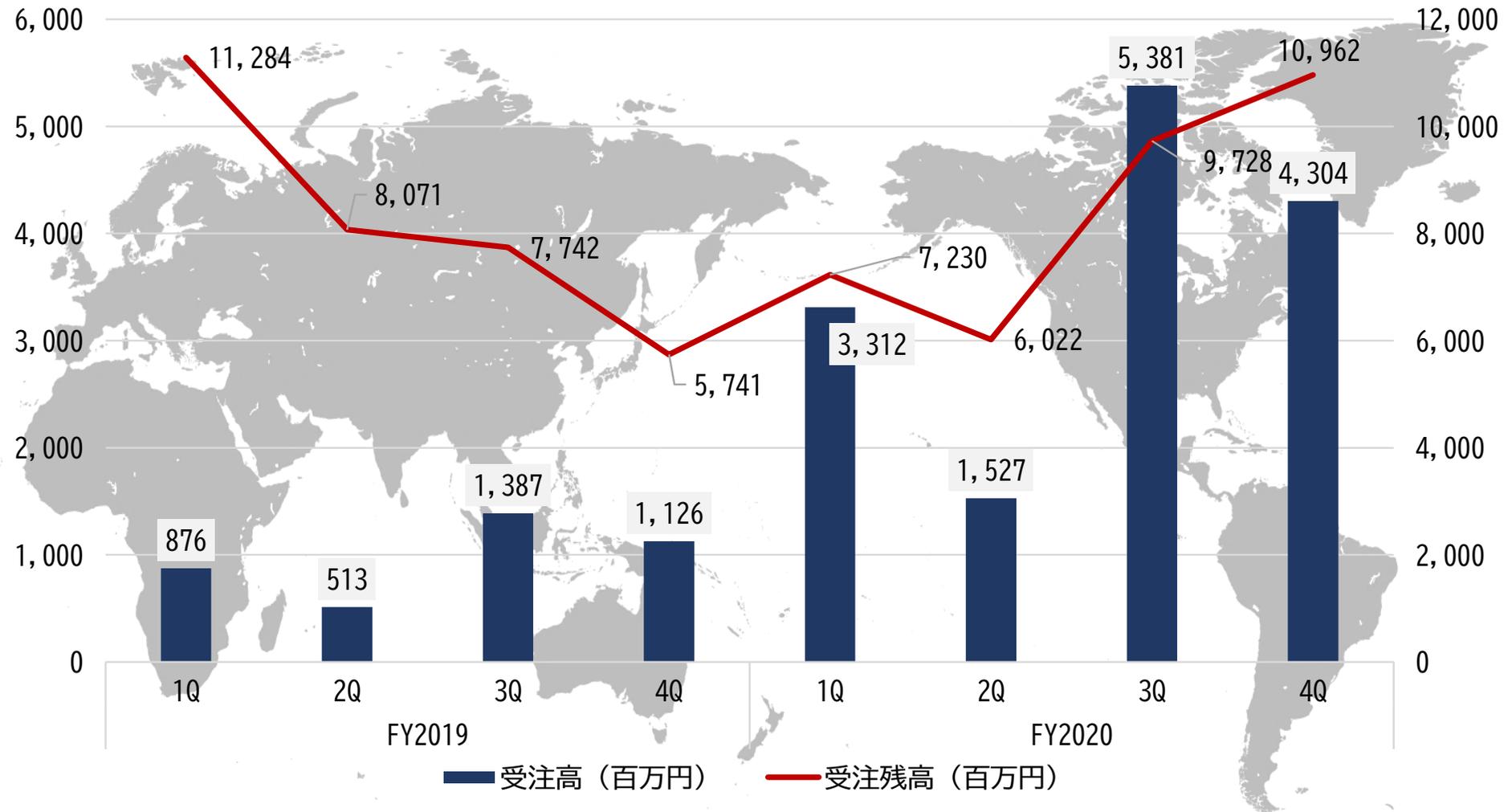
⚙️ ファイナルポリッシャーPN332B

- 300mmファイナルポリッシャーのベストセラー
- 3テーブルあるポリッシュステージで、中研磨から仕上げ研磨まで1テーブルあたり2枚同時研磨することで、装置1台あたり6枚のウェーハを同時研磨可能
- インデックス搬送方式採用のため残り2ヘッドでウェーハのロード/アンロードが可能となり、高生産を実現



半導体関連装置 受注高・受注残高 過去2期四半期推移

半導体業界の設備投資意欲は引き続き強く、今期も受注は好調



今後の取り組み

技術面ではシリコン以外の特殊材料向け高能率機器の開発や積層化への対応を強める

販売面での取り組み

- ・ プロセスを含めたサポート体制を強化
- ・ WLP（ウェーハレベルパッケージ） / PLP（パネルレベルパッケージ）用研削盤の市場投入

技術面での取り組み

- ・ 市場が拡大しているパワーデバイス関連材料であるSiC、GaN、スマートフォンに採用されているSAWフィルター用のLT（タンタル酸リチウム）やLN（ニオブ酸リチウム）など、特殊材料向け専用の高エネルギー研削盤やラップ盤・ポリッシュ盤の開発強化
- ・ 半導体の積層化に係るSi貫通電極ウェーハの低コスト化、超平坦化、金属汚染フリー、薄化加工の技術開発（JST採用のSi貫通電極ウェーハ自動薄化装置の開発継続）
- ・ 車載向けGPU（画像処理）に広く使用されているパッケージ基板用研削盤の開発強化

⚙️ 全自動LT/LNウェーハ枚葉ポリッシャーPNX200L

- LT（タンタル酸リチウム）LN（ニオブ酸リチウム）対応ポリッシャー

⚙️ 200mm オートグラインダーGNX200BH

- 難削材料（SiC, GaN）向け高性能研削盤

⚙️ 難削材料向けマニュアルグラインダーVG401H

- 大型・難削材・特殊材料に柔軟に対応可能なグラインダー



半導体製造装置の機種別分類①

次世代パワーデバイス



GNX200BH
SiCウエーハ用グラインダー



次世代パワー半導体SiC
電気自動車、電車、PC
他

パソコン



GDM300
ウエーハ薄化用
インライングラインダー



スマートフォン
PC
他

ウエーハ



PNX332B
ファイナルポリッシャー



8 “、12” Si材料ウエーハ

スマートフォン



SPP800ATB
バッチ式ウエーハポリッシャー



スマートフォン
SAWフィルター

半導体製造装置の機種別分類②

ソーラパネル



SiSG156HT
太陽電池インゴット複合研削盤



太陽電池・ソーラーパネル

大型液晶



PSG-CHシリーズ
門形平面研削盤



SPP3800
ピッチポリッシャー



液晶 (LCD) テレビ・ディスプレイ

集積回路の高度化

1. 微細化 → 限界に近付きつつある
2. 積層化（3次元化、立体化） → 様々な技術的取り組みが加速

Si貫通電極ウェーハ全自動薄化装置の意味合い

- ・ Si貫通電極（TSV）技術は、あらゆる3次元集積回路の電氣的接続を実現するためのキーテクノロジー、ただし低コスト化と高歩留まり化が最大の課題
- ・ 当社は、新たに開発した自動Si厚さ補正機能付き研削盤、Si/Cu同時研削技術、金属汚染低減化技術を融合させたSi貫通電極ウェーハ全自動薄化装置を開発中（JST採択）
- ・ 同技術の実用化によって、従来のエッチングやCMPを多用した方法に比べ、装置コスト、工程数の低減を実現。チップ積層型3次元集積回路の普及を促し、IoT社会の実現に貢献が可能に

Appendix

～ご参考資料～



世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	<p>【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】</p> <p>工作機械事業 (平面研削盤、成型研削盤、内面研削盤、円筒研削盤、歯車研削盤、専用研削盤、精密歯車、鋳物)</p> <p>半導体関連装置事業 (グラインディングマシン・ポリッシングマシン・ラッピングマシン・スライディングマシン)</p>
従業員数	連結：1,956名 単体：444名 ※2021年3月末現在



研削盤の機種別分類

700万円

PSG-CA シリーズ
(高能率研削仕様)スマートフォン
時計・カメラ
ロボット
自動車
他

2000万円

UPZ-Li シリーズ
(リニアモータ駆動)液晶テレビ
コンピュータ
時計・カメラ
自動車
他

5000万円

UGM360NC
複合加工機自動車
船舶
精密スピンドル
工作機械
他UPG-NCシリーズ
超精密大型研削盤航空機
液晶テレビ
測定器
工作機械
他

半導体製造装置の機種別分類：主力製品

6000万円



GNX200B
SiCウェーハ用グラインダー



次世代パワー半導体SiC
電気自動車、電車、PC
他

15000万円



GDM300
ウェーハ薄化用
インライングラインダー



スマートフォン
PC 他

23000万円



PNX332B
ファイナルポリッシャー



“8、12” Si 材料ウェーハ



SPP800ATB
バッチ式ウェーハポリッシャー



スマートフォン
SAWフィルター

半導体製造装置の機種別分類：関連製品

7000万円



SiSG156HT
太陽電池インゴット複合研削盤



太陽電池・ソーラーパネル

20000万円



PSG-CHシリーズ
門形平面研削盤



30000万円



SPP3800
ピッチポリッシャー



液晶 (LCD) テレビ・ディスプレイ



本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。